ISSN: 1813 – 1662 (Print) E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line) مجلة تكريت للعلوم الصرفة، 21 (7) 2016

دراسة تأثير مقاومية الشريحة وزمن التنميش على مورفولوجية سطوح السليكون المنتجة بالطريقة " الكيميائية الضوئية "

¹ عبد المجيد عياده ابراهيم¹ ، حسن عسكر كاظم² ، امجد حسين جاسم¹ ¹ قسم الفيزياء ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق ² مديرية اعداد المعلمين ، وزارة التربية

الملخص

تشتمل هذه الدراسة تأثير زمن التنميش و المقاومية (Resistivity and Etching Time) على مورفولوجية السطوح المنتجة باستخدام طريقة التنميش الكيميائي الضريئي من شرائح السليكون n-type المستخدمة ، حيث وجد ان زيادة زمن التنميش من 70min الى 100min ادى الى ازدياد الطبقة المسامية من 70min الى 10. الى 11. المستخدمة ، حيث وجد ان زيادة زمن التنميش من 70min المورفولوجية فقد بينت النتائج ازدياد الطبقة المسامية من n 10. الى 11. الى 11. المستخدمة ، حيث وجد ان زيادة زمن التنميش من 70min الى ورفولوجية فقد بينت النتائج زيادة في ارتفاع التراكيب النانوية المنتجة (أي ازداد عمق الحفر) من 11. الى 11. الى 10. الى 10. وهذا يعود زيادة في ارتفاع التراكيب النانوية المنتجة (أي ازداد عمق الحفر) من 11. الى 11. الى 10. اوحت نفس زمن التنميش 70 من 10. وهذا يعود لاختلاف في المقاومية ، اوضحت النتائج التجريبية انه كلما كانت المقاومية اقل كان عمق التنميش اكبر ، السبب يعود في ذلك هو الحرية التي للاختلاف في المعاومية الحار) وامكانية وصولها للسطح بشكل اكبر من الشرائح ذات المقاومية العالية ، وهي المسؤولة عن اختلاف عمق التنميش (الطبقة المسامية). اما الزيادة في المقاومية العمل والمؤلية العالية ، وهي المسؤولة عن اختلاف عمق التنميش (الطبقة المسامية). اما الزيادة في العمق لنفس الشريحة عند زيادة زمن التنميش , فهذا يعود لميكانيكية الاقتلاع التي تقوم بها ذرات الفلور F فكلما (الطبقة المسامية). اما الزيادة في العمق لنفس الشريحة عند زيادة زمن التنميش , فهذا يعود لميكانيكية الاقتلاع التي تقوم بها ذرات الفلور F فكلما (الطبقة المسامية). اما الزيادة في العمق لنفس الشريحة عند زيادة زمن التنميش , فهذا يعود لميكانيكية الاقتلاع التي تقوم بها ذرات الفلور F فكلما (الطبقة المسامية). اما الزيادة في العمق لنفس الشريحة عند زيادة زمن السطح ومحررة غاز الهيدروجين . ان انتايج تراكبول تفوم بها ذرات الفلور F فكلما زاد زمن التنميش كلما غاصت ذرات الفلور مقاطر والسليكون من السطح ومحررة غاز الهيدروجين . ان انتاج تراكبي السليكون النانوي والتحكم في ظروف انتاجها تعتبر الخطوة الاولى للتحكم في خواص النباط (كواشف ، مفارق (Diods)، خلايا شمسية ، متحسات) وتطبيقاتها المناسبة وفي النهي الموي النهاية كل هذا مهم في تعزيز عمليات البحث وبالطوة المتجددة.. ومن الامور المهم التي تعليمة للحمل هي :

الطاقة المتجددة (Renewable Energy) ، التتميش (The aching) ، الخشونة (Renewable Energy) ، السليكون المسامي Nano ، (quantum confinement) ، الحصر الكمي (Photochemical etching) ، الحصر الكمي (technology . technology .

المقدمة

لقد اخذت فكرة تتميش اسطح الشرائح السليكونية اهمية كبيره في علم اشباه الموصلات والخلايا الشمسية لما لها من اثر كبير في تحسين وانتاج نبائط ذات استخدامات واسعة في مفاصل الحياة المختلفة ، ان اعمال التتميش توصلنا الى ما يسمى تقنية النانو على اعتبار أن الجسيمات التي يقل حجمها عن مائة نانومتر (النانومتر جزء من ألف مليون من المتر) تعطي للمادة التي تدخل في تركيبها خصائص جديدة [1]. إذ كلما اقترب حجم المادة من الأبعاد الذرية خضعت المادة لقوانين ميكانيك الكم بدلا من قوانين الفيزياء الكلاسيكية ^[2].

إن اعتماد سلوك المادة على حجمها يمكننا من التحكم بهندسية خواصبها وهنالك طريقتان لتصنيع حجم نانوي من المادة, أحداهما من الأعلى إلى الأسفل (Top-down) والأخرى من الأسفل إلى الأعلى (up-bottom).

ان شرائح السليكون المنمشة يمكن ان تستخدم كمفارق (Diods) وكواشف (Detectors) وقد تستخدم لانتاج خلايا شمسية مطعمة بمواد تزيد من كفاءتها او حتى زيادة المساحة السطحية للخلية الشمسية المعرضة للضوء ، كل هذا من شأنه الحث على الدخول في هكذا ابحاث.

الجانب النظري

مورفولوجية السطح Surface Morphology

إن دراسة المورفولوجية السطحية للمواد تعد ذات أهمية من شانها أن تقسر خواص وسلوك المادة, إذ تتميز المواد النانوية عن غيرها من المواد التقليدية بزيادة المساحة السطحية ووجود معظم ذراتها على تلك الأسطح لأن كل الأنشطة والتغيرات الكيميائية والفيزيائية تحدث دائما على السطح ^[3]. أن دراسة المورفولوجية تبين كيفية توزيع وترتيب الذرات على السطح وتوضيح الاختلاف بالتجانس وبالخواص المتعلقة بكل تركيب بلوري^[5] ومن الطبيعي أن مورفولوجية السطح نتأثر تبعا التقنية المستخدمة وظروف التحضير.

لقد وضحت مورفولوجية سطح الشريحة المحضرة بطريقة التتميش الكيميائي الضوئي (Photochemical Etching) باستخدام فحص مجهر القوة الذرية (AFM) Atomic Force Microscope ، ان السطح يمتلك تركيب نانوي وذا تجانس كبير .

السليكون المسامى النانوى nanoporous silicon

أعطى اكتشاف السليكون المسامي بعدًا جديدًا للتقنيات المعتمدة على السليكون في عام 1990م واكتشاف التألق الضوئي (Photoluminescence) عند درجة حرارة الغرفة من السليكون المسامي من قبل Canham [6] . ان عدم استخدام السليكون الكتلي (Bulk Silicon) في مجال المصادر الباعثة للضوء (LED) , بسبب كون السليكون مادة شبه موصلة ذات فجوة طاقة غير مباشرة

مجلة تكريت للعلوم الصرفة، 21 (7) 2016

(indirect band gap semiconductor) وبالتالي يحدث التألق الضوئي منه عند درجة حرارة الغرفة بشكل صغير جدًا ^[7,6].

أن السليكون المسامي النانوي هو مادة جديدة ذات أهمية كبيرة من الناحيتين العلمية و التطبيقية نظرًا لتمتعها بخواص الحصر الكمي (quantum confinement).

يحضر السليكون المسامى النانوي بعدة طرق منها التتميش الكيميائي الضوئى (Photochemical) لسطح شرائح من السليكون البلوري في محلول مائي من حامضHF وتتركز الأبحاث حاليًا و بشكل مكثف على دراسة خواص السليكون المسامى النانوي كمادة متألقة (luminescent), ولا تقتصر أهمية السليكون المسامى النانوي على التطبيقات الإلكتروضوئية وإنما يعتمد على خواصه كبلورة ذات تألق ضوئي ^[8], والتي تغير في الخواص الضوئية والامتصاصية , الانعكاسية الضوئية مما يجعلها حساسة لأطوال موجية معينة و مفيدة فى التطبيقات الضوئية. من خلال السيطرة على ظروف التنميش (زمن، مواصفات الشريحة ، تركيز الحامض) بحيث يمكن الحصول على بنية بلورية مناسبة للسليكون المسامي النانوي تتمتع بطبقات مختلفة المسامية .كما أن المساحة السطحية الكبيرة للسليكون المسامى النانوي وبنيته السطحية الفريدة وفرت شروطًا مثالية لاستخدامه كمتحسس ضوئي (optical sensor) أو كدايود نتيجة للتباين بين عدد الحاملات غلى السطح وعند القاعدة [3] ، وإن أهمية استخدام السليكون المسامى النانوي في تصنيع الكاشف ضوئي والدايودات ودراسة خواصها الكهربائية، تأتى خصوصًا من الناحية الصناعية مقارنة مع المواد الأخرى المستخدمة في هذا المجال من انخفاض تكلفة تصنيعه و إمكانية تحضير سطحه للحصول على انتقائية عالية (Selectivity) [9] وكذلك توفير المادة الاولية وعدم فقدان الطاقة نتيجة لصغر حجم التصنيع .

التركيب النانوي للسليكون المسامي Nanostructure Porous Silicon

أن السليكون الكتلي هو مادة غير مناسبة للتطبيقات الإلكترونية الضوئية بسبب حدوث العديد من الظواهر غير المشعة والتي تعيق عملية إعادة إتحاد الزوج (إلكترون-فجوة) المشعة . إحدى الطرق الممكنة لزيادة ظاهرة الحصر الكمي نتمثل بحصر حركة حوامل الشحنة

ISSN: 1813 – 1662 (Print) E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line)

والإكسيتون(exciton) في الفراغ البلوري مما يقلل من احتمالية حدوث الظواهر غير المشعة, إذا استطعنا أن نحصر حركة الإكسيتونات في منطقة صغيرة الحجم جدًا بأبعاد من مرتبة النانومتر ومن المعلوم تمامًا بأن خواص المادة في مثل هذه المنطقة تتغير بشكل جذري. بما أن طول موجة دي برولي (De Broglie) للإلكترون أو الفجوة هو من مرتبة (m1-~) فان الجسيمات (الالكترونات والفجوات) في هذه المنطقة تسلك سلوك جسيمات في صندوق و هي مسألة يمكن حلها بواسطة الميكانيك الكمي. ولهذا تسمى عملية حصر الإكسيتونات في منطقة بأبعاد نانومترية بمفهوم الحصر الكمي، و تدعى البنية البلورية الفيزيائية التي يتم فيها حصر الإكسيتونات كميًا بالمادة نانونية التركيب فإن عملية الحصر الكمي بمكن أن تحدث في بعد واحد فقط أو في بعدين أو في ثلاثة أبعاد ^[10].

يقابل كل اتجاه للحصر تغير في المرافق ألموجي للجسيم ونتيجة لذلك تظهر سلسلة من المستويات المنفصلة . وبالأخذ بعين الاعتبار بأن حامل الشحنة حر الحركة في كافة الاتجاهات في الحجم البلوري ، فإنه في البنية ثنائية البعد (2-D) يمكن أن يتحرك بشكل حر فقط في اتجاهين في حين يحدد الاتجاه الثالث اتجاه الحصر الكمي. في البنية أحادية البعد (1-D) هناك اتجاه واحد فقط ممكن للحركة الحرة واتجاهان يمكن للحصر الكمي أن يحدث فيهما. في البنية الصفرية (0-D) يحصل حصرًا كميا كاملا في كافة الاتجاهات و لا يمكن للجسيم المعتبر أن يتحرك حركة حرة على الإطلاق.

يصطلح على تسمية البنية النانونية (D-2) بالبئر الكمي (غشاء رقيق) ويتم الحصول عليها بترسيب طبقات من مواد مختلفة ذات أبعاد من رتبة النانومتر . و تسمى البنية (D-1) الأسلاك الكمية و يتم الحصول عليها بالعمليات الليثوغرافية. وأما البنية (D-0) فتسمى بالنقاط الكمية وتحضر بطرق مختلفة مثل ترسيب البخار الكيميائي، و الزرع الأيوني، و طريقة التنميش الفوتوكيميائى [11] .

يعد السليكون المسامي أحد الأمثلة الهامة للبنى النانوية من النقاط الكمية و يمكن تشكيله في بنية تتائية أو ثلاثية البعد, شكل (1) يعد تمثيلا تخطيطيًا لنماذج البنى النانونية المختلفة ^[11].

ISSN: 1813 – 1662 (Print) E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line)



شكل (1) تمثيلا تخطيطيا لنماذج التركيبات البلورية النانوية [12]

طرائق تحضير السليكون المسامي النانوي Preparation طرائق تحضير السليكون المسامي النانوي

هنالك عدة طرائق لتحضير السليكون المسامي وان خصائص هذا

السليكون تختلف من طريقة إلى أخرى. وفيما يأتى أهم الطرائق

- الشائعة في تحضير السيليكون المسامى:
- (a) التنميش الفوتوكيميائي Photochemical etching
- Photoelectrochemical للتميش الكهروكيميائي الضوئي (b) etching
 - (c) التنميش البقعي
 - (d) التنميش بالليزر (التقشيط)
 - (e) التنميش الكهروكيميائي Electrochemical etching

وإن الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة التنميش الكيميائي الضوئي

(a) التنميش الفوتوكيمياني او الكيمياني الضوني Photochemical etching

لقد تم اختيار طريقة التنميش الكيميائي الضوئي في هذا البحث وذلك لتميزها عن غيرها بالتحكم الكبير في خواص السليكون المسامي المنتج وانتاج مساحات سطحية كبيرة ومتجانسة كون الضوء المسلط على النماذج يكون ذا توزيع متجانس وبشكل عمودي والذي يؤدي الى انتاج تراكيب نانوية متشابهة نسبيا .



شكل (2) رسم تخطيطي للخلية الفوتوكيميائية.

خلال عملية تكوين النمش هنالك ذرتان من الهيدروجين متآصره مع ذرة السيلكون ونسب ذرات الهيدروجين تقل عندما تصل الى نظام الصقل الالكتروني عند السطح وتختفي خلال هذه العميلة، التفاعل شبه الكروي للانود خلال عملية تكوين الثقب تكتب معادلته بهذه الصيغة :

 $Si + 6HF \rightarrow H_2SiF_6 + H_2 + 2H^+ + 2e^-$ (1) e j a sultra e the end of the end

 $Si + 6HF \rightarrow H_2SiF_6 + 4H^+ + 4e^-$ (2) $Si + 6HF \rightarrow H_2SiF_6 + 4H^+ + 4e^-$ (2) Illility Illility النقب والثابت لوجود السليكون داخل HF وتفاعلهما معا تنتج H_2SiF_6 او تكوين بعض ايوناته. هذا يعني اثناء عملية تكوين الثقب فان اثنين من الالكترونات الاربع الموجودة على ذرة السليكون تترك الذرة وتنتقل مع الجزء المزال بينما الاثنين الاخرين يبقيان ملتصقان الذرة وتنتقل مع الجزء المزال بينما الاثنين الاخرين يبقيان ملتصقان على ذرة السليكون وتعاني التآكل والتحرر لاحقا . بالمقابل خلال على ذرة السليكون وتعاني كل الكترونات السليكون الاربع تكون فعالة عملية الصقل الالكتروني كل الكترونات السليكون الاربع تكون فعالة كيميائيا Lehmann and Gösele الميكانيكية الاكثر قبولا للانحلال شكل (3).



الشكل (3):مخطط تحلل السيليكون المقترح من قبل Lehmann and Gosele [14, 13].

الجزء العملي Experimental part

تم اختيار شرائع سليكون n-type وباتجاهية (100) ومقاوميتين نوعيتين ($\rho_{\rm L}=4.3 \times 10^{-4} \Omega$. cm و $\rho_{\rm h}=10 \Omega$.cm) على التوالي وذلك لدراسة تأثير المقاومية (المقاومة النوعية) على عمليات التتميش (القشط) الكيميائي الضوئي حيث تم دراسة تأثير زمن التتميش على الطبقة المسامية المنتجة ويأخذ زمنين مختلفين (min 7) في الحالة الأولى و (min 100) في الحالة الثانية وتطبيقها على العينة بالمواصفات (100 min) في الحالة الثانية وتطبيقها على العينات هو (mu 10 ± 250) وقطعت بأبعاد (200 × 1) تعسل العينات بالاسيتون والايثانول لازالة المواد العالقة ثم توضع في حامض الهيدروفلوريك HF ويتركيز % 10 لمدة عشر ثوان وذلك لازالة طبقة الاوكسيد التي عادة تكون على سطح السليكون .

بعد نتظيف عينات السليكون يتم غمرها في HF 40% داخل وعاء من التقلون مستندة على مسندين من نفس مادة التقلون شكل (2) بحيث يكون سطحها اللامع الى الاعلى باتجاه نصدر الضوء وبهذه الطريقة يتم تجهيز الفجوات (الشحنات الموجبة) اللازمة لقيام عملية التتميش بالميكانيكية الموضحة في شكل (3) . المصدر الضوئي المستخدم في هذه التجربة هو مصباح هالوجين (W 1000) مجهز

من شركة Phillips والذي يوفر شدة اضاءة ذات توزيع متجانس على سطح العينات لضمان تجانس الطبقة المنشة حيث يتم التحكم بشدة الاضاءة من خلال تحريك المصدر الضوئي بتقريبه من العينة لشدة اضاءة (LUX ^{10⁵} LUX) يمكن الحصول عليها عندما تكون على بعد 20m من العينة وقد تركزت هذه الدراسة على الاتي : 5-1 دراسة تأثير مقاومية الشريحة على مورفولجية الطبقة المسامية

في هذا الجزء تم اختيار عينتين من شرائح السليكون n-type بنفس المواصفات الهندسية $2 \, \mathrm{cm}^2$ عدا اختلافهما بالمقاومية (cm) المواصفات الهندسية $0.5 \, \mathrm{cm}^2$ عدا اختلافهما بالمقاومية ($\rho_L = 4.3 \times 10^{-4} \, \Omega. \mathrm{cm}$ و $\rho_h = 10 \, \Omega$. $4 \, \mathrm{LUX}$ و $0.5 \, \mathrm{cm}^2 \, \mathrm{cm}$ وسدة اضاءة (LUX) وشدة اضاءة ($70 \, \mathrm{min}$) وسدة اضاءة من الزمن $10^5 \, \mathrm{cm}^3$ من الرمن $10^5 \, \mathrm{cm}^3$ ور ($1.5 \, \mathrm{cm}^3$) في كلتا الحالتين وبعد فترة من الزمن $10^5 \, \mathrm{cm}^3$ والتميش والتي تكون فقاعات على سطح الشريحة دلالة على بدأ عملية الحفر او التتميش والتي تكون احدى نتائجها تكون فقاعات الهيدروجين وحسب الميكانيكية الموضحة في شكل (3) مع ملاحظة اختلاف عدد وحجم الفقاعات بين الشريحتين.



شكل (4) مورفولوجية السطح لعينتين من السليكون n-type واتجاهية (100) اجريت عليها عملية تنميش كيميائي ضوئي تحت شدة اضاءة

. (70 min) وياستخدام (HF 40%) ويزمن تنميش (1.5 ×10⁵ LUX)

 $\rho_l = 4.3 \times 10^{-4} \ \Omega. \ cm \ -b \qquad \qquad \rho_h = 10 \ \Omega. \ cm \ -a$





شكل (5) التوزيع الاحصائى لاحجام الجسيمات النانوية المكونة على السطح للعينتين (a,b) في شكل (4) على التوالي .

دراسة تأثير زمن التنميش على مورفولوجية الطبقة المسامية تم اختيار عينتين من شرائح السليكون n-type بنفس المواصفات الهندسية (Ω.cm) والتركيبية (100) والمقاومية (Ω.cm) وباستخدام نفس ظروف التحظير من ناحية شدة اضاءة (LUX) 10⁵ LUX و ((40% HF) ولكن بزمني تنميش مختلفين وهما (70 min) في الحالة الاولى و (100 min) في الحالة

الثانية علما انه في الحالة الثانية كانت عملية التنميش بمرحلتين (min) ثم تركت العينة (48 h) ونمشت لمدة (30 min) ليكون الزمن الكلي(100 min) وباستمرار العملية نلاحظ تكون فقاعات الهيدروجين وتغير لون سطح العينة الى لون قريب من لون الصدأ وهذه دلائل اولية على حدوث عملية التنميش وتكون المسامات.

ISSN: 1813 – 1662 (Print) E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line)



شكل (6) مورفولوجية السطح لعينتين من السليكون n-type واتجاهية (100) والمقاومية (ρ=10 Ω.cm) اجريت عليها عمليات التنميش الكيميائي الضوئي تحت شدة اضاءة (LUX × 10⁵ LUX) وياستخدام (HF40%) . (a) – عينة منمشة بزمن تنميش 70 min . (b) -عينة منمشة بزمن تنميش 100 min .



شكل (7) التوزيع الاحصائي لأحجام الجسيمات النانوية المكونة على السطح للعينتين (a,b) في شكل (6)على التوالي .

النتائج والمناقشة

في هذا الجزء من البحث تم دراسة وتحليل نتائج مجهر القوة الذرية AFM) Atomic Force Microscope) من خلال دراسة اشكال واحجام الجسيمات النانوية المتشكلة والتي كانت اقطار معظمها يبتراوح بين 20 mm 120 - 60، وهي ضمن مديات الجسيمات ذات البعد النانوي ، كما يمكن تحديد سمك الطبقة المسامية وكذلك التوزيع الاحصائي لحجم هذه الجسيمات ووضع تفسيرات علمية لتشكلها . تعتبر نتائج مجهر القوة الذرية قاطعة لما لها من غزارة في المعلومات التي يوفرها مثل معدل الخشونة (Average Roughness) و قيمة متوسط الجذر التربيعي للجسيمات المشكلة (Root Mean Square) ومعدل المسافة بين وقيمة التواء السطح (Surface Skewness) ومعدل المسافة بين قمتين (Peak-Peak) والكثير من المعلومات التي على اساسها يمكن

تفسير خواص النبائط المصنعة ، فالتحكم في انتاج طبقات مسامية بمواصفات معينة تكون مقدمة لاستخدامها في تطبيقاتها اللائمة ، وكما تم ذكره في البند (3) فان العمل يتركز في جزئين :

(A) – دراسة مقاومية شريحة السليكون على موفولوجية الطبقة المسامية المنتجة عندما تكون جميع ظروف التحظير نفسها البند (3– (1) حيث كانت احدى الشريحتين ذات مقاومية العالية (2–(a–4)) ميث اظهرت نتائج مجهر القوة الذرية AFM شكل (4–a) تكون طبقة مسامية سمكها (178 nm) وبتراكيب شبه كروية بمعدل قطر (nm 20.7 nm) والتوزيع الاحصائي للجسيمات المشكلة يظهر مدى لاقطار هذه الجسيمات نتراوح مابين nm (80 الى 120) واعلى نسبة مئوية هي للجسيمات باقطار (90nm) حيث تنلغ %1.85 ويمكن ملاحظة التفاصيل الاخرى في الجدول المرفق

مجلة تكريت للعلوم الصرفة، 21 (7) 2016

مع شكل (a-5) اما معدل الخشونة للسطح فقد كان (0.48 nm) وان قيمة متوسط الجذر ألتربيعي يساوي (0.56nm) والتواء السطح (0.083 nm) .

اما نتائج مجهر القوة الذرية لعينة السليكون ذات المقاومية الواطئة التي تم تحظيرها بنفس الظروف فقد ($ho_{
m L}=4.3 imes10^{-4}~\Omega.cm)$ تبينت الطبقة المسامية بانها مختلفة عن سابقتها من حيث سمك هذه الطبقة الذي يساوي (nm) وكذلك من ناحية نوزيع الجسيمات التي كانت عبارة عن تراكيب جدارية واخاديد طولية ذات ابعاد كبيرة نسبيا مقارنة مع عدد القمم المتكونة والتي تعطينا دلالة على اذابة اكبر للطبقة المسامية ، وبمقارنة سمك هذه الطبقة (10nm) مع العينة ذات المقاومية الاعلى التي كان سمكها (4.78 nm) تؤكد تعرض العينة الثانية ذات المقاومية الاقل الى عمليات اذابة لطبقاتها ، ويمكن تفسير ذلك بالرجوع الى ميكانيكية الاذابة في شكل (3) حيث ان المقاومية القليلة تعنى انطلاق الفجوات (الشحنات الموجبة) بعدد اكبر داخل العينة باتجاه السطح ومن ثم حدوث عملية الاذابة على عكس العينة ذات المقاومية العالية التي تلاقى فيها الشحنات الموجبة (الفجوات) مقاومة داخلية (خلال طبقة السليكون) اثناء حركتها باتجاه السطح وهـذا يفسـر تكـوين جسـيمات ورؤوس بعـدد اكبـر فـي العينـة ذات المقاومية الاعلى .

معدل الخشونة السطحية (1.55nm) للعينة ذات المقاومية ρ_L مقارنة مع معدل الخشونة السطحية (0.484 nm) للعينة ذات المقاومية ρ_h مع معدل الخشونة السطحية (0.484 nm) مع معدل الخشونة السطح (1.97 nm) مقارنة مع (0.56 nm) للحالة الاولى والتواء السطح (0.28) للعينة ذات مع (0.0837) للحالة الاولى والتواء السطح (0.28) للعينة ذات مد (0.0837) و التوزيع الاحصائي والنسب المئوية فهي مبينة في شكل (5-d)

(B) يخص هذا البند دراسة تأثير زمن النتميش على مورفولوجية (B) يسطح العينات المحظرة حسب الظروف الموضحة في البند (3–2) سطح العينات المحظرة حسب الظروف الموضحة في البند (3–2) و حيث تركيز الحامض % 40 وشدة الاضاءة (LUX) و ($\rho = 10 \ \Omega \ .cm$) ولكن زمن النتميش متغير حيث كان للعينة الاولى $t_1=70$ min وللعينة الثانية الثانية (مرحلتين).

نتائج فحص AFM للعينة الاولى اظهرت بان سمك الطبقة المسامية نتائج فحص AFM للعينة الاولى اظهرت بان سمك الطبقة المسامية هو (A. 17nm) وتراكيبها بابعاد النانو كانت تغطي تقريبا %50 من سطح العينة ومعدل الخشونة السطحية لهذه العينة كانت (nm 8.0) والتواء وان قيمة متوسط الجذر التربيعي للجسيمات (nm 10.2) والتواء السطح (nm) ومسافة قمة الى قمة (nm) 3.52 mm) ما بالنسبة لاقطار الجسيمات والرؤوس على السطح (n8 20) واكبر نسبة مئوية للاقطار هي (n0 100) وبنسبة %25 كما موضح فى الجدول المرفق مع شكل (-a) .

بالنسبة للعينة التي حظرت بزمن نتميش (100 min) فقد اظهرت نتائج فحص AFM تكوين تراكيب نانوية تتراوح مابين (70nm -60) وهي تعتبر مثالية ضمن العينات التي تم تحظيرها .اما سمك

ISSN: 1813 – 1662 (Print) E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line)

الطبقة المسامية فقد كان (11.32nm) كما موضح في شكل (b-5) ، الزيادة في السمك مقارنة مع (4.17 nm) للعينة الأولى فسرت على اساس زيادة زمن التنميش تعطي فرصة اكبر للعدد اكثر من الشحنات الموجبة للوصىول الى السطح ومن ثم زيادة عملية التنميش الكيميائي الضوئي ، وبالنسبة لأشكال هذه التراكيب فهي مختلفة عن جميع التراكيب التى سبقتها من العينات المحظرة كونها حضرت بمرحلتين فقد اجريت عليها عملية التنميش لمدة 70min كمرحلة اولى ثم بعد 48 h اجريت عليها عملية تتميش لمدة min وهذا يفسر تكوين رؤوس صغيرة على تراكيب اكبر منها شكل (b-6) وهذه بحد ذاتها طريقة مبتكره للحصول على جسيمات بأبعاد اصغر تتكون على جسيمات اكبر منها حجما . معدل الخشونة لهذه العينة هو (1.87 nm) في حين العينة المنمشة بالزمن(t1=70 min) كانت (0.8 nm) وقيمة متوسط الجذر التربيعي (2.14 nm) وان قيمة متوسط الجذر التربيعي تمثل (مجموع الارتفاعات والانخفاضات السطحية تربيع مقسومة على حاصل جمع عددهما الكل تحت الجذر التربيعي) وهذه القيمة تفسر وتوضح معدل خشونة السطح فكلما زادت قيمة متوسط الجذر التربيعي دل على زيادة معدل الخشونة السطحية للغشاء وبالعكس , ويمكن الاستفادة من ذلك في كيفية الحصول على مورفولوجية السطح للعينة حسب التطبيقات المطلوبة .مقارنية مع (0.92 nm) للعينية المحضرة بزمن تتميش (min) والتواء السطح (nm 0.24 nm) مقارنة مع (nm 3.52) للعينة المحضرة بزمن تتميش (70 min) .

الإستنتاجات والمقترحات:

- الاستنتاجات:

 1- يزداد سمك الطبقة المنمشة من سطح شريحة السليكون بانخفاض مقاومية الشريحة المستخدمة .

2- يزداد سمك الطبقة المنمشة من سطح شريحة السليكون بزيادة زمن التتميش للشريحة المستخدمة .

3- يقل معدل الحجم الحبيبي للسطح المنمش مع زيادة زمن النتميش وسببه الزيادة في العمق وتأكل جدران التراكيب الجدارية ، كون شكل الحفر سوف يكون عبارة عن تراكيب الجدارية واخاديد .

4- بزيادة زمن التتميش تزداد الخشونة السطحية ويعكس هذا على كثافة المسامات .

- المقترحات :

 1- دراسة تأثير تراكيز مختلفة من حامض HF على الخصائص الطبوغرافية للسطح المنمش.

استخدام الليزر وبطاقات مختلفة في اجراء عملية التنميش .

3- المقارنة بين طريقتي التتميش الفوتوكيميائي والفوتوالكتروكيميائي ضمن ظروف مماثلة من زمن وشدة اضاءة.

4- دراسة تأثير ترسيب بعض المواد التي نتمتع بوجود الكترونات حرة
 كثيرة في اغلفتها الخارجية ومدى تأثيرها في تصنيع (Diod)
 وخصائصه الكهربائية .

المصادر

[8] Mischa Megens, Judith E. G.J.Wijnhoven, Ad Lagendijk, and Willem L. Vos, Physical Review A 59(6), (1999).

[9] Gullis A G and Canham L T Nature 353, (1991).

[10] S. Ossicini, L. Pavesi, F. Priolo. 'Light Emitting silicon microphotonic 'springer-verlag heidelberg. printed Germany (2003).

[11] Harrison P. Quantum well, wires and dots: Theoretical .Phys. J. Wiley & Sons Ltd. chisester (2000).

[12] Alessia Irrera, "Light emitting devices based on silicon nanostructures", Universita Degili Studidi Catania, Dottorato Diricerca in Scienza Materiali, (2003).

[13] A.M. Alwan, "Electrical properties of porous silicon prepared by photo chemical Etching "Regional conference on sold state science and Technology ,(2005).

[14] الانترنيت.

[1] محمد صالح الصالحي, عبدالله صالح الضويان - قسم الفيزياء والفلك- كلية العلوم- جامعة الملك سعود مقدمة في تقنية النانو، 2007م

[2] Mark Ratner, Dan Ratner, Nanotechnology Gentle Introduction, Harvard University, Brown University (2002).

[3] علاء يوسف على مصلح " تصنيع ودراسة خصائص كاشف ضوئي نوع CdS على سليكون مسامي بطريقة الرش الكيميائي الحراري " (رسالة ماجستير) K كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة تكربت (2011).

[4] Dr.Axel Zweck, Technological analysis, Future technologies division ,Germany,(2004).

[5] S.Rengaraj, S. Hee, S. Venkataraj, Y. Kim, S. Vijayalakshmi, E. Repo, A. Koistinen, M. Sillanpaa. Dep. Chem. Phys. Univ. Eastern Finland, Patteristonkatu,Finland,J.Nanoscience.Vol.11.(2011)

[6] C. Baratto, G. Faglia, G. Sberveglieri, Z. Gaburro,
L. Pancheri, C. Oton and L. Pavesi, Sensors 2, (2002
[7] Canham L T Appl. Phys. Lett. 57, (1990).

Study the effect resistivity slide and the time of etching on silicon surfaces morphology of producing photovoltaic method

Abdul Majeed E.Ibrahim¹, Hasen Askar Kadhem², Amjad hossen jasem¹

¹ physics department, College of Education for pure science department, Tikrit University, Tikrit, Iraq ² Directorate prepare teachers, Ministry of Education

Abstract

Our work focusing on studying the effect of the etching time and Resistivity on morphology of the Surfaces which is producted by the photochemical etching method from the wafer silicon n-type which is used ,where is found by increasing the etching time from 70min to 100 min the high of the nano structural is increasing from 4.17nm to 11.3 nm of same n-type silicon wafer, while we studying the Resistivity effect on morphology the results was declare increasing in the product nano structures(i.e the depth etching increase) from 4.11nm to 10 nm under same etching time 70 min of the difference of the wafer resistance and the etching time, and how that s be effecting on the Surface Topographic for the used silicon wafers, Where as much as with increasing the etching time for same wafer the etching depth increasing .

This is up to difference in resistance ,Every time the resistance less that's the aching depth longer, The reason of that, the freedom that's carriers (holes) have it and accessibility to the surface with shape great than from the wafers have high resistance. So the resistance which responsible of different among aching depth. Either increase in depth for same wafer by increase the aching time, that's up to the extraction mechanism which the fluore atoms do it, every time increase the aching time the F atoms floundered at the surface extractioning the si atoms from the surface and freeing H gas and the prodected nano silicon and ruling in its producting conditions considering the first steep of ruling in the devices properties (sensors, Diods, sensors. photocells) and its applications.

At the end all of this is important in forware the searching operations and the developing of renewable.